

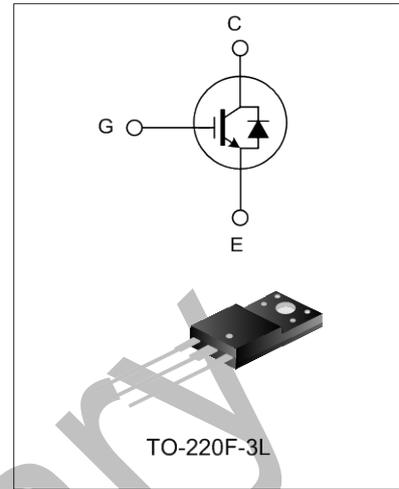
15A、600V绝缘栅双极型晶体管

描述

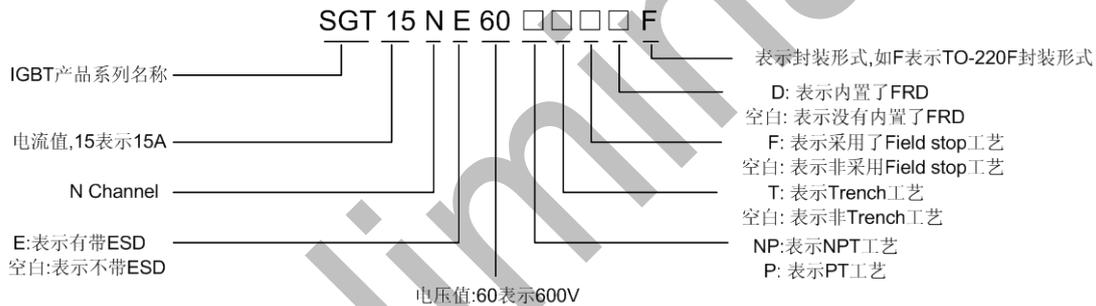
SGT15N60NPFDF 绝缘栅双极型晶体管采用场截止 (Field Stop) 工艺制作, 具有较低的导通损耗和开关损耗, 该产品可应用于 UPS, SMPS 以及 PFC 等领域。

特点

- ◆ 15A, 600V, $V_{CE(sat)}(\text{典型值})=2.0V@I_C=15A$
- ◆ 低导通损耗
- ◆ 快开关速度
- ◆ 高输入阻抗



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SGT15N60NPFDF	TO-220F-3L	15N60NPFDF	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	参数范围	单位
集电极-射极电压	V_{CE}	600	V
栅极-射极电压	V_{GE}	± 20	V
集电极电流	I_C	$T_c=25^\circ\text{C}$	30
		$T_c=100^\circ\text{C}$	15
集电极脉冲电流	I_{CM}	60	A
耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_D	100	W
工作结温范围	T_J	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

热阻特性

参 数	符 号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻 (IGBT)	$R_{\theta JC}$	3.7	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对管壳热阻 (FRD)	$R_{\theta JC}$	5.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	51.2	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

IGBT 电性参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集射击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0V, I_C=250\mu A$	600	--	--	V
集射漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=600V, V_{GE}=0V$	--	--	200	μA
栅射漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=20V, V_{CE}=0V$	--	--	± 400	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=250\mu A, V_{CE}=V_{GE}$	4.0	5.5	7.0	V
饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=15A, V_{GE}=15V$	--	2	2.5	V
		$I_C=15A, V_{GE}=15V$	--	2.4	--	V
		$T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	--	--	--
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30V$	--	486	--	pF
输出电容	C_{oes}	$V_{GE}=0V$	--	60	--	
反向传输电容	C_{res}	$f=1\text{MHz}$	--	21	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=300V$ $I_C=15A$ $R_g=24\Omega$	--	5	--	ns
开启上升时间	T_r		--	37	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	40	--	
关断下降时间	T_f		--	121	--	
导通损耗	E_{on}	$V_{GE}=15V$	--	0.48	--	mJ
关断损耗	E_{off}	感性负载	--	0.14	--	
开关损耗	E_{st}		--	0.62	--	
栅电荷	Q_g	$V_{CE}=300V, I_C=15A, V_{GE}=15V$	--	26	--	nC
发射极栅电荷	Q_{ge}		--	4	--	
集电极栅电荷	Q_{gc}		--	15	--	

FRD 电性参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向压降	V_{FM}	$I_F=12A, T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	1.9	2.6	V
		$I_F=12A, T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	1.5	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$I_{ES}=12A, di_{ES}/dt=100A/\mu s$	--	32	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}	$I_{ES}=12A, di_{ES}/dt=100A/\mu s$	--	31	--	nC

典型特性曲线

图1. 典型输出特性

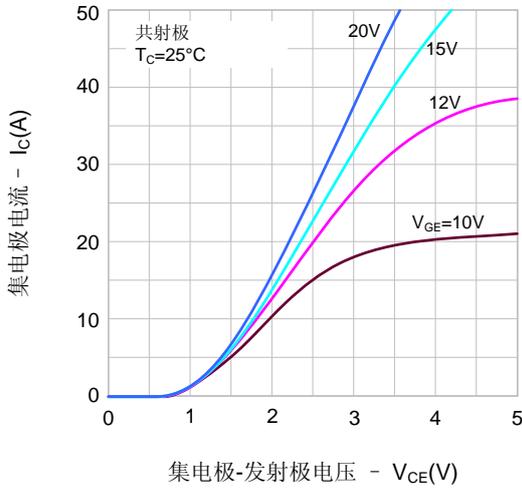


图2. 典型饱和压降特性

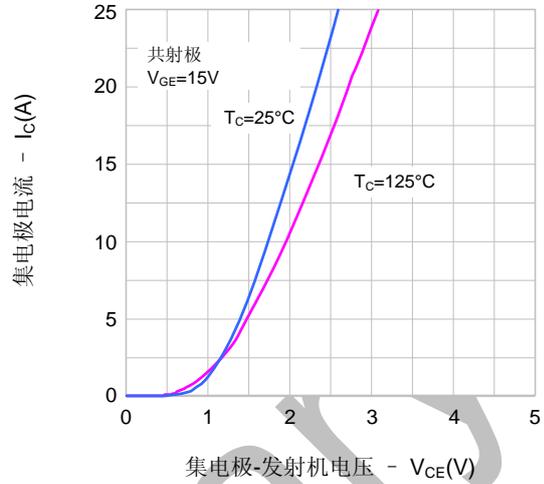


图3. 传输特性

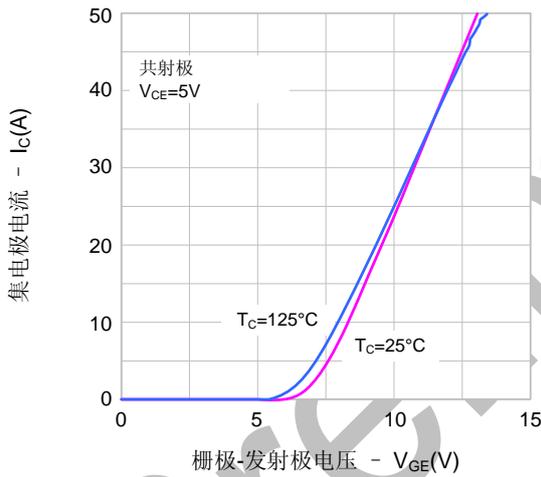


图4. 饱和压降 vs. V_{GE}

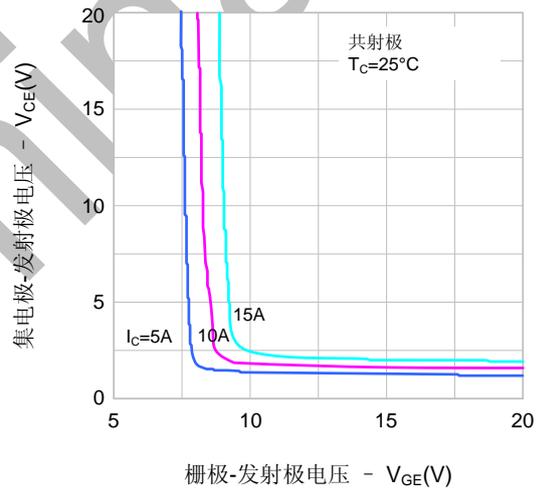


图5. 饱和压降 vs. V_{GE}

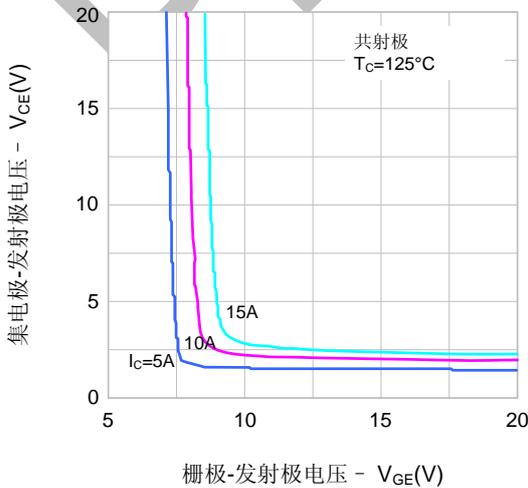
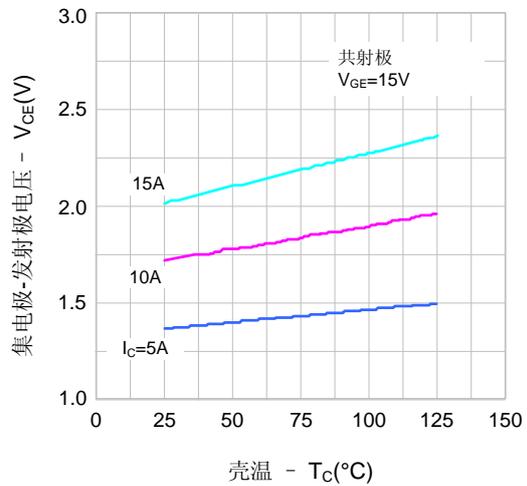


图6. 饱和电压 vs. 温度



典型特性曲线 (续)

图7. 电容特性

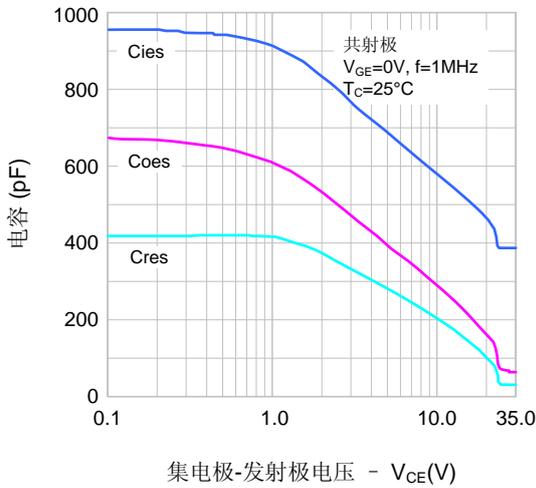


图8. 栅极电荷特性

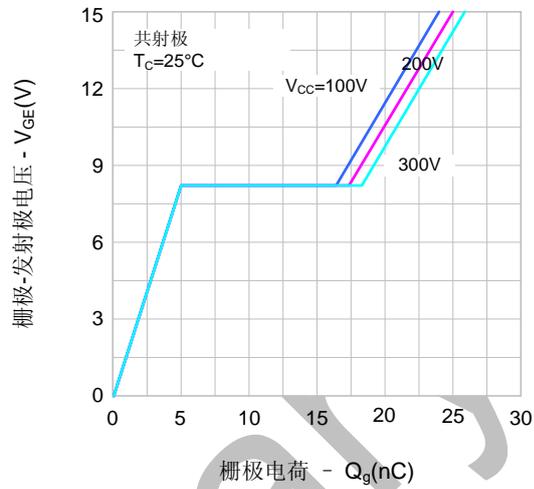


图9. 导通特性 vs. 栅极电阻

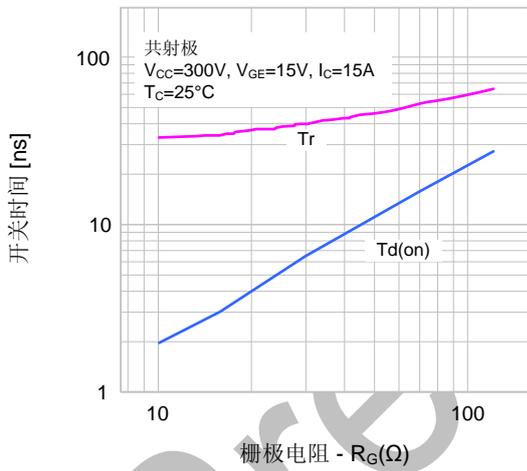


图10. 关断特性 vs. 栅极电阻

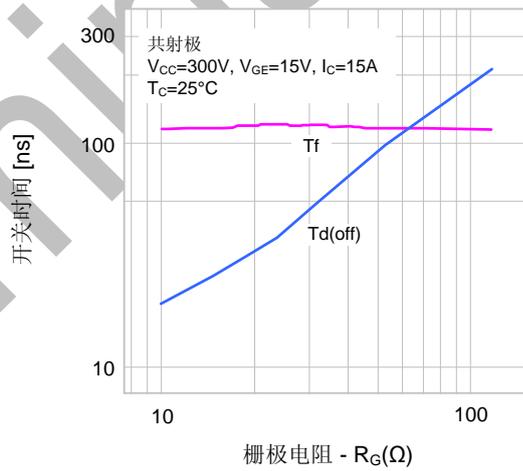


图11. 开关损耗 vs. 栅极电阻

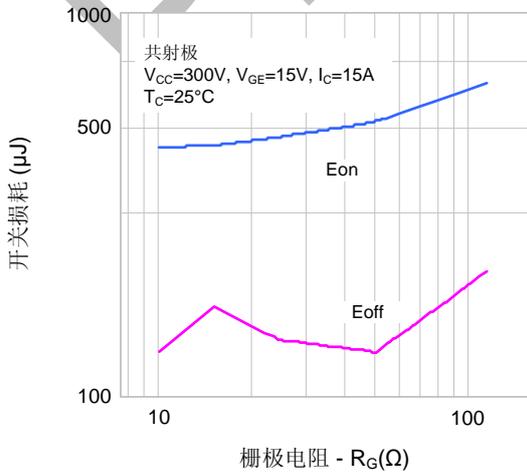
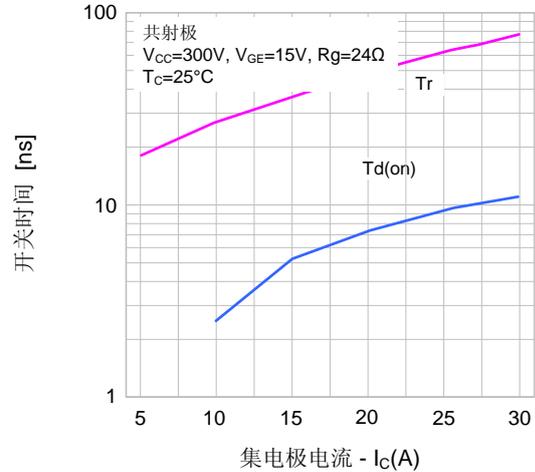


图12. 导通特性 vs. 集电极电流



典型特性曲线 (续)

图13. 关断特性 vs. 集电极电流

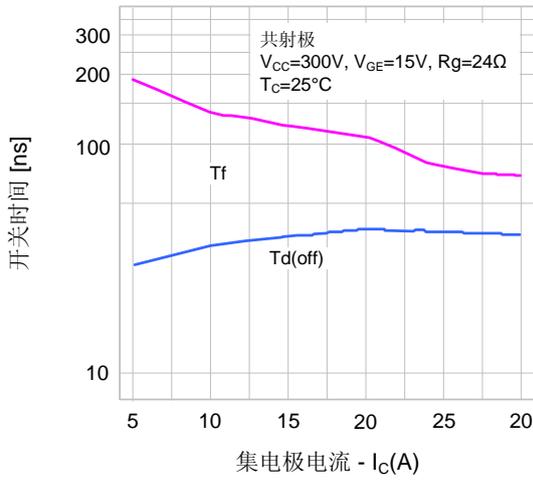


图14. 开关损耗 vs. 集电极电流

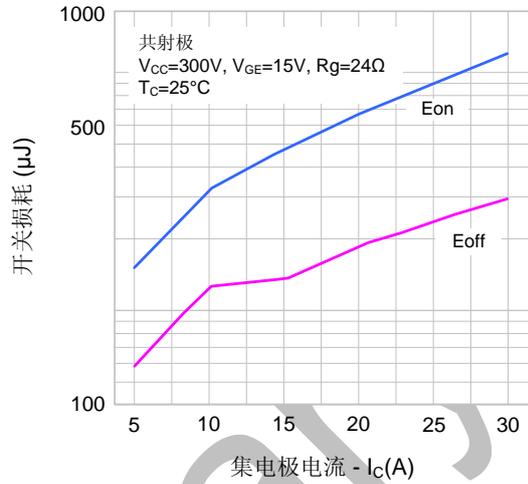


图15. 正向特性

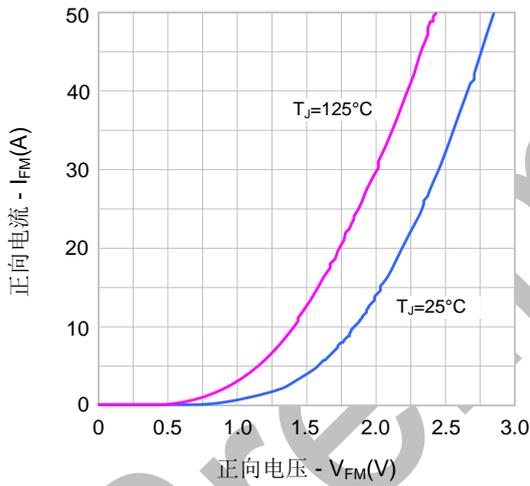
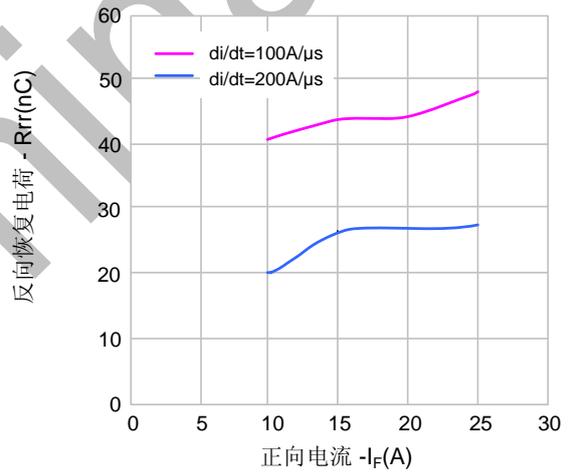
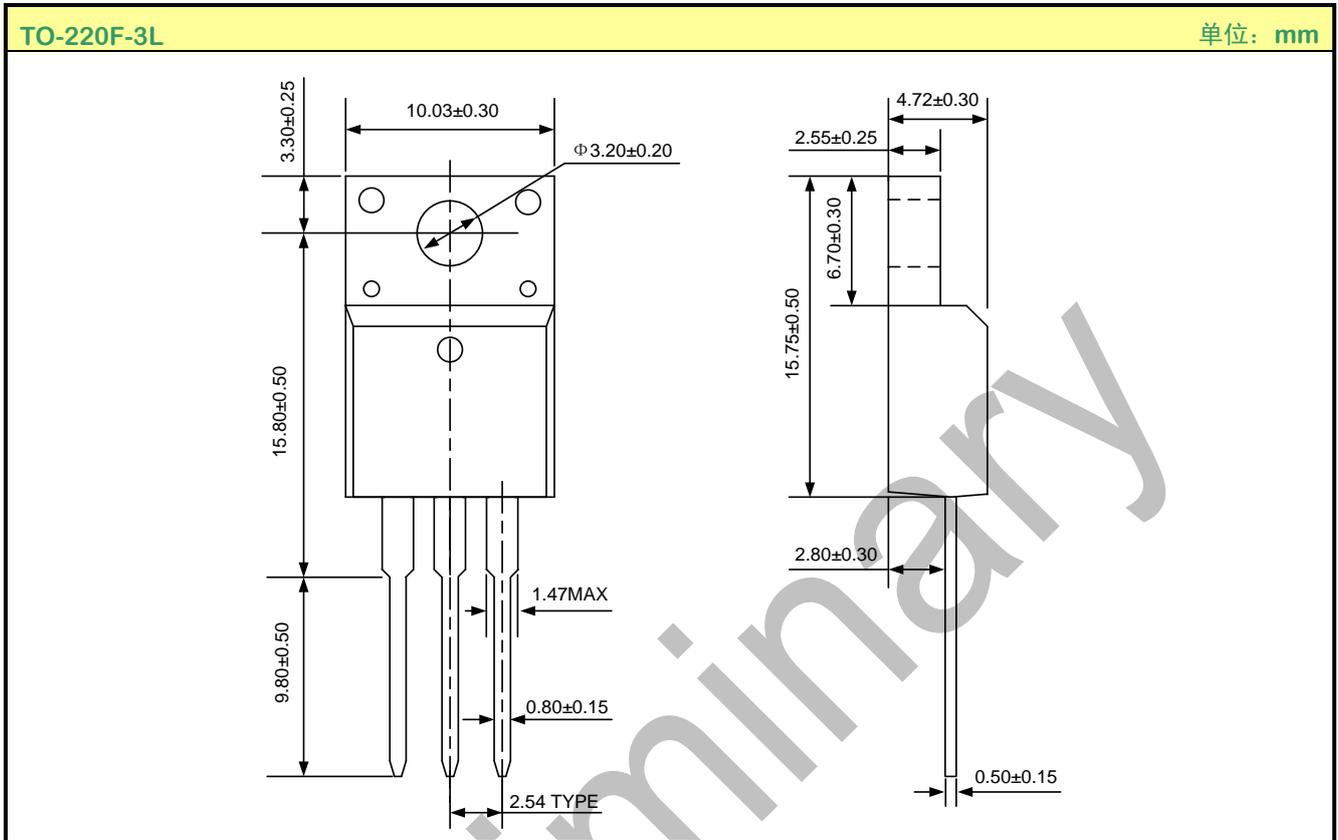


图16. 反向恢复电荷 vs. 正向电流



封装外形图



MOS电路操作注意事项:

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- ◆ 操作人员要通过防静电腕带接地。
- ◆ 设备外壳必须接地。
- ◆ 装配过程中使用的工具必须接地。
- ◆ 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称:	SGT15N60NPFDF	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	0.2	作 者:	张科锋
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 修改典型特性曲线

版 本:	0.1	作 者:	张科锋
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 初稿
-

Preliminary